

第 1 1 回 三菱マテリアル・早大理工学術院 産学連携セミナー

主催：三菱マテリアル-早大理工連携協議会

共催：各務記念材料技術研究所

2008年に三菱マテリアル株式会社と産学連携に係る包括協定を締結して以来、その活動の一環として、毎年ホットなテーマで連携セミナーを開催して参りました。

11年目を迎えた本年度は、「次世代自動車と材料技術」をテーマとした連携セミナーを下記の通り開催いたします。

会期	2018年10月26日（金）13:00～17:25		
場所	早稲田大学 西早稲田キャンパス 63号館 04会議室（63-2-02-04）、05会議室（63-2-02-05）		
セミナー 内容	時間	演題	講演者（敬称略）
	13:00-13:05	開会挨拶	早稲田大学 理工学術院 連携協議会早稲田側メンバー 教授 山崎 淳司
	13:05-14:05	次世代自動車技術に関する将来展望	早稲田大学 次世代自動車研究機構 特任研究教授 大聖 泰弘
	14:05-15:05	樹脂モールド SiC パワーモジュールと冷却器の メッキレス、フラックスレス、低温接合技術開発	早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 総合機械工学科 教授 吉田 誠
	15:05-15:20	コーヒーブレイク	
	15:20-16:20	材料技術（アルミのロールキャストイング） と次世代自動車について	大阪工業大学 工学部 機械工学科 教授 羽賀 俊雄
	16:20-17:20	高信頼性セラミックス絶縁回路基板における 金属/セラミックス接合技術	三菱マテリアル株式会社 中央研究所 パワーエレクトロニクス材料研究部 部長 長友 義幸
	17:20-17:25	閉会挨拶	三菱マテリアル株式会社 中央研究所 所長 磯部 毅
座長	13:05-15:05 15:20-17:20		早稲田大学理工学術院 連携協議会早稲田側事務局 早稲田大学 理工学術院 連携協議会早稲田側メンバー 教授 鈴木 進補
対象	本学学生・教職員、三菱マテリアル株式会社関係者、一般		
定員	100名程度（原則として受付先着順といたします）		
参加費	無料		
申込先	理工学術院 研究総合支援課		
申込手続	人数の把握のため、可能な限り事前申込にご協力をお願いします。その場合、研究室に所属されている学生は、研究室単位で申込願います。申込方法等は下記をご確認ください。		
締切	2018年10月12日（金）（目安、以降応相談）		
備考	終了後、懇親会（17:30～19:00）を63号館1Fロームスクエアにて開催（会費無料）		

申込・問合せはこちら

早稲田大学理工センター研究総合支援課 担当：藤原、藤澤

連絡先：03-5286-8069 メール：mmcjimu@list.waseda.jp

※申し込み方法

個人：右記必要事項記入の上メールにて御連絡ください。氏名/連絡先/所属/メールアドレス/懇親会出席可否

研究室所属の方：申込用紙（研究総合支援課HP掲載）に記入後、代表者（学生の方）からメールにて御連絡ください。